



Sayı : E-34221550-720-11085

Tarih: 06.08.2026

Konu : PackExpo Chicago 2026 Alım Heyeti Duyurusu Hk.

**TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)**

İlgi : ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı'nın 05.08.2026 tarihli e-postası.

İlgide kayıtlı yazıda, 18-21 Ekim 2026 tarihleri arasında Chicago, Illinois'de PACK EXPO International 2026 fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Pack Expo International, paketlenme, işleme, otomasyon ve ambalaj teknolojilerindeki en son yeniliklerin sergilendiği bir fuar olup, söz konusu fuara sektörün önde gelen firmalarının yanı sıra yaklaşık 45.000 sektör profesyonelinin katılımının beklendiği iletilmektedir.

Ücretsiz fuar girişinden ve heyet avantajlarından yararlanabilmek için kabul edilen delegelerin kayıtları ABD Ticaret Müsteşarlığı tarafından resmi heyet kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, katılımcıların uçak bileti, konaklama, şehir içi ulaşım ve kişisel harcamalarının taraflarınca karşılanacağı ve heyet hizmet bedelinin kişi başı 100 ABD doları olduğu ifade edilmektedir.

Heyet kaydı tamamlanan katılımcılara davet mektubu temin edilecek olup Uygunluk ve Konsolosluk Bölümünün kapasitesi doğrultusunda, grup vize randevusu talebi konusunda destek sağlanabilmektedir. Bu destek, vize randevusu veya vize verilmesini garanti etmemektedir.

Söz konusu heyete katılmak ve belirtilen hizmetlerden yararlanmak isteyen firmaların 4 Eylül 2026 tarihine kadar Naz Demirdöven (naz.demirdoven@trade.gov) ve Ayşesu Celasun (aysesu.celasun@trade.gov) ile iletişime geçmeleri mümkündür.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Sarp KALKAN
Genel Sekreter Yardımcısı

